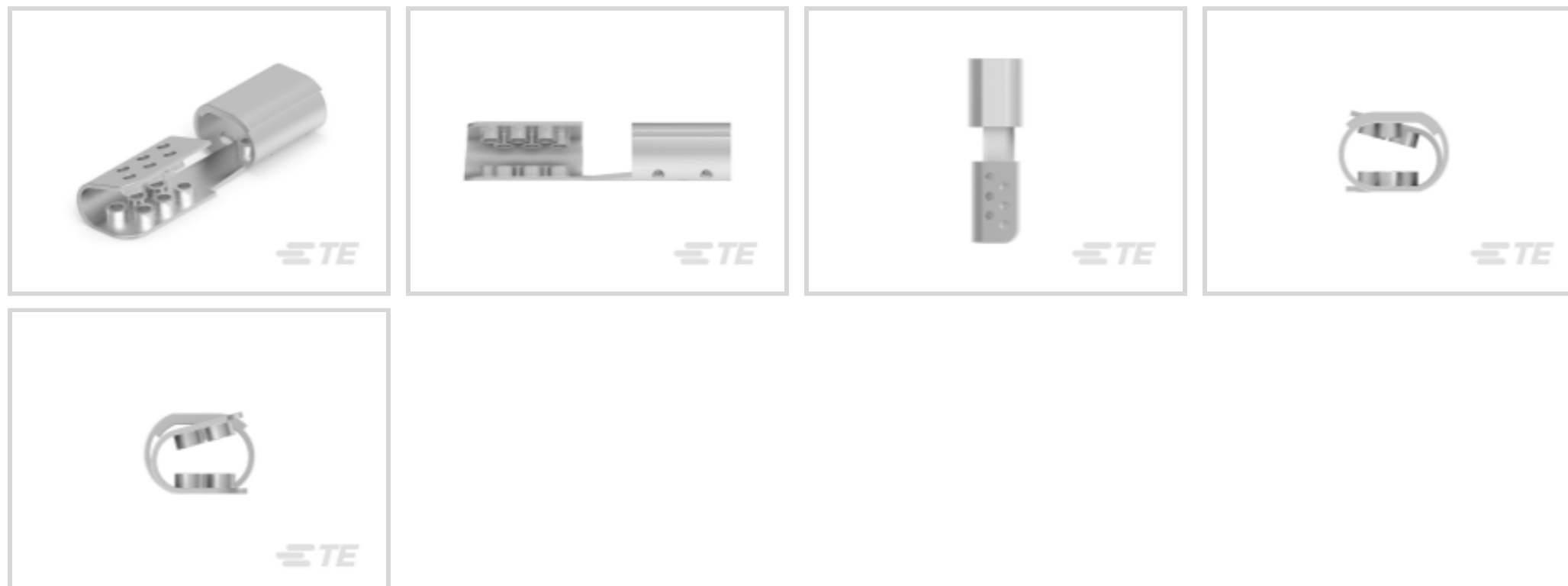




端子 and 接头 > 箔片端子



适用的箔片厚度（最大值）：.4 mm [.016 in]

端子电镀材料：锡

封装方法：Box

工作温度范围：150 °C [302 °F]

产品特性

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---

端接特性

适用的箔片厚度（最大值）	.4 mm [.016 in]
--------------	-----------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度范围	150 °C [302 °F]
--------	-----------------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | TERMI-FOIL



客户还购买了



文档

产品图纸

SPLICE,TERMI-FOIL BOND CLIP

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1-332006-0_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-332006-0_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-332006-0_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-332006-0_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-332006-0_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-332006-0_H.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES](#)

英文版本